



PRESSEMITTEILUNG

Weltmarktführer SiC Processing GmbH begibt 100-Millionen-Euro-Anleihe

- **SiC-Processing-TechBond: Inhaber-Teilschuldverschreibung mit 7,125 Prozent p. a. über 5 Jahre**
- **Hohe Bonität: Creditreform-Rating mit Investment Grade BBB+**

Hirschau, 15.02.2011 – Die SiC Processing GmbH aus Hirschau, ein Spezialdienstleister für die Photovoltaik-Industrie, setzt auf nachhaltiges Wachstum, um dem steigenden Bedarf der Branche gerecht zu werden. Finanziert werden soll die geplante Expansion u. a. aus dem Emissionserlös der Unternehmensanleihe, dem SiC-Processing-TechBond (ISIN: DE000A1H3HQ1). Mit einer Festverzinsung von 7,125 Prozent p. a. über eine Laufzeit von fünf Jahren will das Unternehmen mit einem Emissionsvolumen von 100 Mio. Euro neben institutionellen Investoren auch Privatanleger ansprechen. „Wir haben uns als Technologieführer in einer zukunftsorientierten Branche etabliert und sind für die Zukunft bestens aufgestellt“, sagt Thomas Heckmann, Gründer und Geschäftsführer der SiC Processing GmbH, und erläutert den geplanten Ausbau der Produktionskapazitäten: „Vor allem in den Boom-Märkten Asiens werden wir in den kommenden Jahren erfolgreich weiter wachsen.“

In nur zehn Jahren hat sich die SiC Processing GmbH mit einem aktuellen Marktanteil von ca. 40 Prozent als weltweit führendes Dienstleistungsunternehmen im Bereich der Aufbereitung gebrauchter Sägesuspension (Slurry) aus der Photovoltaik-Industrie etabliert. Sägesuspension wird bei der Herstellung von Silizium-Wafern eingesetzt, nutzt allerdings bei der Verwendung im Laufe der Zeit ab. Die SiC Processing GmbH erreicht durch ihr patengeschütztes Verfahren in der Rückgewinnung und Aufbereitung von gebrauchter Sägesuspension eine Ausbeute, die andere industrielle Methoden bislang nicht ermöglichen. Das spart enorme Kosten in der Wafer-Produktion bei gleichbleibend hoher Produkt-Qualität, so dass nahezu alle namhaften Produzenten auf die Aufbereitungstechnologie von SiC Processing vertrauen.

Der SiC-Processing-TechBond kann ab dem 16. Februar 2011 direkt über das Unternehmen erworben werden. Über ein Anleiheinformationszentrum beantwortet die SiC Processing GmbH telefonisch Fragen zur Anleihe und zur Abwicklung des Kaufs. Darüber hinaus



können Anleger das Wertpapier auch über das Anleihe Segment Bondm der Börse Stuttgart zeichnen. Ausdruck des Vertrauens in die hohe Solidität und Wirtschaftskraft des Unternehmens ist das aktuelle BBB+ Rating der Creditreform Rating AG, die SiC Processing klar im Bereich Investment Grade sieht.

Weitere Informationen zum SiC-Processing-TechBond erhalten interessierte Anlegerinnen und Anleger im Anleiheinformationszentrum, montags bis freitags von 8.00 bis 18.00 Uhr, unter der kostenfreien Rufnummer +49 (0)800 22 44 060

Ein rechtlich maßgeblicher Wertpapierprospekt wird unter www.sic-processing.com zum Download und zur kostenlosen Abgabe bei der SiC Processing GmbH, Dienhof 26 in 92242 Hirschau, bereitgehalten.

Eckdaten zum SiC-Processing-TechBond:

Emissionsvolumen:	Bis EUR 100.000.000,00
Stückelung:	EUR 1.000,00
Mindestanlage:	EUR 1.000,00
ISIN:	DE000A1H3HQ1
Laufzeit:	01.03.2011 bis 29.02.2016
Börsennotiz:	Bondm Börse Stuttgart
Zins:	7,125 % p.a.
Zinszahlungen:	jährlich, erstmals zum 01.03.2012
Rückzahlungskurs:	100 %
Wertpapierart:	Inhaber-Teilschuldverschreibung

Über die SiC Processing GmbH:

Mit rund 700 Mitarbeitern steigerte die SiC Processing GmbH den Umsatz im Jahr 2010 um 54 Prozent auf 160 Millionen Euro. Das EBITDA erhöhte sich im selben Zeitraum um 50 Prozent auf 51 Millionen Euro. Derzeit verfügt die SiC Processing GmbH über Produktionsstandorte in Deutschland, China, den USA, Norwegen und Italien mit einer jährlichen Aufbereitungskapazität von 215.000 Tonnen Sägesuspension. Neben dem Mehrheitseigner Nordic Capital ist die Gründerfamilie mit 25 Prozent am Unternehmen beteiligt.

Ansprechpartner für Pressefragen : Markus Kreuzer
Marketing and Communications Manager
Telefon: 0049 (0) 9622 - 70 39 273
E-Mail: markus.kreuzer@sic-processing.de